

厦门华侨电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“厦华电子”）于2017年12月30日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其他相关公告。2018年1月16日，公司董事会收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0076号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订。如无特别说明，本修订说明中的简称均与《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

本次修订的主要内容如下：

1、“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司股权结构的影响”及“第一章本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司股权结构的影响”中补充披露了本次交易对上市公司控制权稳定性的影响及上市公司稳定控制权的具体措施。

2、“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（四）上市公司控股股东股票质押情况对公司控制权的影响”及“第一章本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（四）上市公司控股股东股票质押情况对公司控制权的影响”中补充披露了股票质押对上市公司控制权稳定性的影响及

控制股票质押风险的具体措施。

3、“重大事项提示”之“六、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市”之“（三）本次交易不构成重组上市”及“第一章本次交易概况”之“八、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市”之“（三）本次交易不构成重组上市”中补充披露了本次交易不存在规避重组上市的情形。

4、“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（一）本次交易方案已获得的授权和批准”及“第一章本次交易概况”之“三、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（一）本次交易方案已获得的授权和批准”中补充披露了福光股份关于本次交易的授权和批准情况。

5、“第四章标的公司情况”之“十一、标的公司其他情况说明”之“（一）标的公司股东与标的资产及其实际控制人何文波之间关于拟 IPO 或重组的相关协议安排或约定情况”中补充披露了标的公司股东与标的资产及其实际控制人何文波之间关于拟 IPO 或重组的相关协议安排或约定情况。

6、“第三章交易对方的基本情况”之“三、配套资金认购方鹰潭当代的详细情况”之“（四）主要财务数据”及“（七）本次认购资金来源”中补充披露了鹰潭当代认购本次配套募集资金的认购能力及资金来源情况。

7、“第五章发行股份情况”之“四、本次募集配套资金失败的补救措施”中补充披露了上市公司自筹资金来源及可行性，并在“特别风险提示”之“一、与本次交易有关的风险”之“（十）无法按时完成现金对价支付的风险”中补充披露了无法按时完成现金对价支付的风险。

8、“第四章标的公司基本情况”之“五、标的公司业务发展情况”之“（二）所属行业基本情况”中补充披露了标的资产所属行业概况。

9、“第四章标的公司基本情况”之“五、标的公司业务发展情况”之“（四）标的公司经营模式”及“（五）标的公司核心竞争力”中补充披露了标的公司的经营及盈利模式和核心竞争力情况

10、“第四章标的公司基本情况”之“八、标的公司主要资产及其权属状况、对外担保、主要负债及配比情况”之“（一）主要资产情况”中补充披露了标的

公司主要资产情况。

11、“第八章本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易完成后上市公司未来经营的优势和劣势”之“(三)上市公司整合能力分析”中补充披露了上市公司整合能力情况。

12、“第四章标的公司基本情况”之“五、标的公司业务发展情况”之“(三)标的公司主要产品”中补充披露了标的公司主要产品情况。

13、“第四章标的公司基本情况”之“六、标的公司主要财务数据”之“(二)标的公司主营业务收入情况”、“(三)标的公司利润主要来源分析”及“(四)标的公司产品毛利率情况”中补充披露了标的公司按产品类型区分的主营业务收入及其变化情况、利润来源情况及产品毛利率变动情况。

14、“第四章标的公司基本情况”之“六、标的公司主要财务数据”之“(五)报告期内主要客户情况”中补充披露了报告期内主要客户情况。

15、“第四章标的公司基本情况”之“五、标的公司业务发展情况”之“(六)标的公司知识产权情况”中补充披露了标的公司知识产权情况。

16、“第四章标的公司基本情况”之“五、标的公司业务发展情况”之“(七)标的公司人员情况”中补充披露了标的公司人员情况。

17、“第四章标的公司基本情况”之“六、标的公司主要财务数据”之“(六)标的公司研发投入情况”中补充披露了标的公司研发投入情况。

18、“第四章标的公司基本情况”之“六、标的公司主要财务数据”之“(七)标的公司主要生产设备及折旧情况”中补充披露了标的公司主要生产设备及折旧情况。

19、“第四章标的公司基本情况”之“六、标的公司主要财务数据”之“(八)报告期资产变动分析”中补充披露了资产规模、收入规模增长的具体原因。

20、“第四章标的公司基本情况”之“六、标的公司主要财务数据”之“(九)报告期净利润变动分析”中补充披露了毛利率及净利率下降的原因。

21、“重大事项提示”之“五、业绩承诺与补偿安排”及“第一章本次交易概述”之“五、业绩承诺与补偿安排”中补充披露了业绩承诺仅对累积实现的实际净利润数进行承诺。

22、“重大事项提示”之“五、业绩承诺与补偿安排”及“第一章本次交易概述”之“五、业绩承诺与补偿安排”中补充披露了业绩补偿方案约定的具体补偿方式、计算公式等情况。

23、“第四章标的公司基本情况”之“二、设立及历史沿革”中补充披露了标的公司的历史沿革情况。

24、“第四章标的公司基本情况”之“三、标的公司的股权结构情况”之“（四）股东关联关系”中补充披露了标的公司各股东间的关联关系及其他关系。

25、“第四章标的公司情况”之“十一、标的公司其他情况说明”之“（二）标的公司股东与标的公司及其实际控制人之间其他安排”中补充披露了标的公司股东与标的公司及其实际控制人之间的股份回购等安排的情况。

26、“第六章标的公司基本情况”之“三、评估模型及参数的选取”及“四、评估值及增值主要原因”之“（一）评估结果差异分析”中补充披露了评估方法的选择依据、相关说明及主要参数。

27、“第六章标的公司基本情况”之“四、评估值及增值主要原因”之“（二）评估增值依据及合理性”中补充披露了评估增值的具体依据和合理性。

28、“第一章本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易方案概述”中补充披露了未收购标的公司 100%股权的原因，并在“第一章本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”之“（三）支付现金购买资产”中补充披露了现金对价支付安排。

29、公司在《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》和《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）摘要》摘要修订稿中修改并更新披露了部分文字错漏。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日